



2024年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

2023年9月29日

上場会社名 三益半導体工業株式会社 上場取引所 東
コード番号 8155 URL <https://www.mimasu.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 八高 達郎
問合せ先責任者 (役職名) 管理本部 本部長 (氏名) 中島 孝之 (TEL) 027-372-2021
四半期報告書提出予定日 2023年10月13日 配当支払開始予定日 -
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年5月期第1四半期の業績(2023年6月1日~2023年8月31日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年5月期第1四半期	20,259	0.8	3,002	△6.3	3,071	△4.6	2,136	△4.3
2023年5月期第1四半期	20,104	17.8	3,203	75.7	3,219	74.6	2,233	74.4

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年5月期第1四半期	66.51	-
2023年5月期第1四半期	69.52	-

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年5月期第1四半期	116,915	77,513	66.3
2023年5月期	124,339	76,396	61.4

(参考)自己資本 2024年5月期第1四半期 77,513百万円 2023年5月期 76,396百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年5月期	-	32.00	-	32.00	64.00
2024年5月期	-	-	-	-	-
2024年5月期(予想)	-	32.00	-	32.00	64.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2024年5月期の業績予想(2023年6月1日~2024年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	86,000	△5.4	10,300	△7.8	10,150	△7.7	7,030	△7.7	218.84

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年5月期1Q	35,497,183株	2023年5月期	35,497,183株
② 期末自己株式数	2024年5月期1Q	3,373,230株	2023年5月期	3,373,211株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2024年5月期1Q	32,123,953株	2023年5月期1Q	32,124,574株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期貸借対照表	4
(2) 四半期損益計算書	6
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報)	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な資源価格高騰などの影響を受けたものの設備投資や個人消費が持ち直すなど、緩やかな回復基調となりました。

半導体シリコンウエハーの生産は、引き続きデバイス市場における在庫調整の影響を受けました。一方で、当社の主要なユーザーである半導体関連各社の設備投資は、底堅く推移しました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。

この結果、当第1四半期累計期間の売上高は202億5千9百万円と前年同四半期比0.8%の増収となりましたが、営業利益は30億2百万円(前年同四半期比6.3%減)、経常利益は30億7千1百万円(同4.6%減)、四半期純利益は21億3千6百万円(同4.3%減)となりました。

セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。なお、売上高及び利益には、セグメント間の内部取引に係る金額が含まれております。

半導体事業部

当事業部はデバイス市場における在庫調整の影響を受けました。

この結果、当事業部の売上高は118億1千2百万円(前年同四半期比13.8%減)、セグメント利益(営業利益)は24億7千5百万円(同10.1%減)となりました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。

この結果、自社開発製品及びその他の取扱商品ともに増収となり、当事業部の売上高は87億8千9百万円(前年同四半期比35.9%増)、セグメント利益(営業利益)は4億5千7百万円(同16.7%増)となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

この結果、当事業部の売上高は13億3千万円(前年同四半期比35.6%増)、セグメント利益(営業利益)は1億9千9百万円(同38.7%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少等により、前事業年度末と比較して74億2千4百万円減少し、1,169億1千5百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の減少等により85億4千万円減少し、394億2百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加11億8百万円等により、775億1千3百万円となりました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の見通しにつきましては、半導体デバイス市場における在庫調整等の影響により予断を許さない状況が続くものと予想されます。

そうした中で当社といたしましては、引き続きより高精度かつ生産性の高い加工プロセスを確立し競争力の強化を図るとともに、自社製品等の拡販を積極的に進め、業績の向上に努めてまいります。

なお、未定としておりました2024年5月期の業績予想及び配当予想につきましては、本日、別途「業

績予想及び配当予想に関するお知らせ」にて開示いたしております。通期業績は、売上高 860 億円、営業利益 103 億円、経常利益 101 億 5 千万円、当期純利益 70 億 3 千万円を見込んでおります。

また、年間配当金につきましては、前期と同額の 1 株当たり 6 4 円とし、中間配当金及び期末配当金をそれぞれ 1 株当たり 3 2 円とする予定であります。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2023年5月31日)	当第1四半期会計期間 (2023年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	27,240	14,984
受取手形及び売掛金	40,063	37,128
商品及び製品	4,692	3,617
仕掛品	1,370	1,350
原材料及び貯蔵品	4,347	4,959
その他	3,349	1,525
貸倒引当金	△4	△3
流動資産合計	81,059	63,562
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	21,502	21,083
機械及び装置(純額)	8,461	7,940
建設仮勘定	3,298	14,308
その他(純額)	4,521	4,966
有形固定資産合計	37,783	48,299
無形固定資産	809	845
投資その他の資産	4,687	4,207
固定資産合計	43,280	53,353
資産合計	124,339	116,915
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	30,919	26,274
未払法人税等	3,172	603
引当金	110	491
その他	13,533	11,413
流動負債合計	47,735	38,782
固定負債		
退職給付引当金	41	6
その他	166	613
固定負債合計	207	619
負債合計	47,943	39,402

(単位：百万円)

	前事業年度 (2023年5月31日)	当第1四半期会計期間 (2023年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	43,466	44,574
自己株式	△4,772	△4,772
株主資本合計	76,295	77,404
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	140	170
繰延ヘッジ損益	△39	△61
評価・換算差額等合計	100	108
純資産合計	76,396	77,513
負債純資産合計	124,339	116,915

(2) 四半期損益計算書
(第1四半期累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年8月31日)	当第1四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年8月31日)
売上高	20,104	20,259
売上原価	15,007	15,906
売上総利益	5,096	4,353
販売費及び一般管理費	1,892	1,350
営業利益	3,203	3,002
営業外収益		
受取利息	0	0
受取配当金	7	9
為替差益	39	19
保険解約返戻金	—	32
その他	6	18
営業外収益合計	54	80
営業外費用		
固定資産除売却損	38	11
その他	0	0
営業外費用合計	38	11
経常利益	3,219	3,071
特別利益		
投資有価証券売却益	—	18
特別利益合計	—	18
特別損失		
投資有価証券売却損	—	2
特別損失合計	—	2
税引前四半期純利益	3,219	3,087
法人税、住民税及び事業税	1,123	521
法人税等調整額	△137	429
法人税等合計	985	950
四半期純利益	2,233	2,136

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前第1四半期累計期間(自 2022年6月1日 至 2022年8月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	13,695	6,409	—	20,104	—	20,104
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1	57	981	1,040	△1,040	—
合計	13,696	6,466	981	21,144	△1,040	20,104
セグメント利益	2,752	392	143	3,288	△85	3,203

(注) 1 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3 エンジニアリング事業部は開発部門としての役割に特化しており、販売に関しては産商事業部を通じて行うため外部顧客への売上高は発生しておりません。

当第1四半期累計期間(自 2023年6月1日 至 2023年8月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	11,812	8,447	—	20,259	—	20,259
セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	341	1,330	1,672	△1,672	—
合計	11,812	8,789	1,330	21,932	△1,672	20,259
セグメント利益	2,475	457	199	3,133	△130	3,002

(注) 1 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3 エンジニアリング事業部は開発部門としての役割に特化しており、販売に関しては産商事業部を通じて行うため外部顧客への売上高は発生しておりません。